

Orbotech Jetext™

最先端ICパッケージ向けマーキング用印刷装置

最先端パッケージヘインクジェットによるマーキング

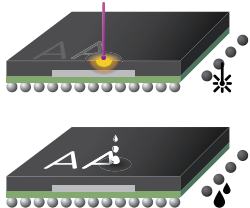
最先端の高性能電子デバイスの製造は、小型化、薄型化の方向へ継続的に進んでおり、厚み僅か数百ミクロン程度の製品も採用されています。パッケージの小型化の重要性がますます高まっており、トレーサビリティが目的のマーキングとして、レーザーアブレーション工法に代わり、インクジェット方式による印刷が注目されています。

表面ダメージをなくし、歩留まりを向上

小型化されたパッケージへのマーキングを、従来のレーザー（彫刻技術）よりインクジェット方式へ変更した際の利点として：

- 製造現場で実証された非接触印刷工法
- レーザーアブレーション工法にて懸念される部品周辺への熱影響の排除
- 従来の工法に比べ、印字密度に関係なく一貫した高いスループットとクリアなマーキングを提供
- デザインやCAMの柔軟性が向上
- コントラストの改善により、より鮮明なマーキングを実現

インクジェットマーキングは、製品へのリスクのない工法であり、かつ高精度な印刷機能も有しているため、次世代超薄型半導体メモリパッケージに採用されています。



Orbotech Jetext - マーキング用途

DotStream Pro™ (ドットストリーム・プロ) テクノロジーを搭載した、CAMとの親和性のあるOrbotech Jetextは、従来のレーザーや汎用な2Dコード印刷に比べ、熱や接触によるダメージリスクをなくし、よりスマートかつ安定した結果を提供します。

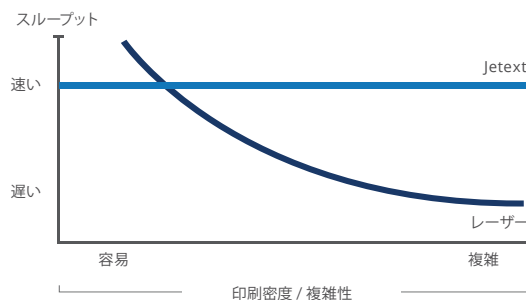
独自のインクコントロールシステムにより、凸凹のある表面に対して、高精度なパターンアライメントと高速で微細な印刷機能により、鮮明で均一な印刷品質を提供いたします。



最新の柔軟なインクにより、レーザーアブレーションでは、熱ストレスで対応できなかったパッケージサブストレートへのマーキングを実現。

高い位置合わせ精度 ($\pm 35 \mu\text{m}$) があり、幅広いフォントタイプや小さな文字サイズへの高コントラスト印刷をサポート

- 業界標準の印刷品質と精度
- 独自のアライメントモジュール
- ストリップ、JEDECトレイなどに対応
- 異なるサブストレート上で様々なインクタイプに対応



Orbotech Jetextの印刷スループットは、印刷密度や複雑性に関係なく、サブストレートのサイズによって決まります。

仕様

最大印刷サイズ	304.8 x 406.4 mm
最小 / 最大ストリップ厚み	0.1 - 6.5 mm
最小 / 最大解像度	600 - 2400 dpi
最小線幅	75 μm
最小文字高さ	0.3 mm
位置精度 (FTG)	± 35 μm
最大間隔 PH/サブストレート	1.5 mmまで
アライメント方式	ユーザー選択可能; ターゲットマーク数、パーシャルスケーリング
ストリップ / パネルアタッチメント	標準: ストリップハンドリング 真空 + クランプ オプション: カスタマイズキャリア、JEDECトレイ、パネル
ソフトウェア	RIPソフトウェア – CAMとの統合、274Xの入力、ワンタッチ印刷、多言語対応
適用インク	様々なオルボテック推奨インク
寸法 W x D x H*	1000 x 1150 x 2240 mm
重量	900 kg
オートメーション	オートメーション接続可能

* 高さはタワーライトを含みます

KLA SUPPORT

高い歩留まりを実現するKLAのソリューションにとって、装置の生産性維持は非常に重要です。この実現のため、当社ではメンテナンス、グローバルでのサプライチェーン管理、コスト削減、製品ライフサイクル管理、装置移設、性能・生産性の向上、認証ツールの再販売などに注力しています。

© 2022 KLA Corporation. KLAは全世界において著作権に関する権利を有します。当社は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアの仕様を予告なく変更する権利を有します。「オルボテック」は、KLAカンパニーであるOrbotech Limitedの登録商標です。「KLA」とKLAのロゴは、KLA Corporationの登録商標です。記載されたブランド名および製品名は全て各社の登録商標である可能性があります。

KLA Corporation
TEL: 045-522-7725
Email: Japan-ICS-PCB@kla.com
www.kla.com

Rev 1.0_6-09-2022 (J)